



Flux à base d'eau sans COV PacIFic 2009MLF

INTERFLUX®
ELECTRONICS N.V.



Fiche technique PacIFic 2009MLF

Ver: 3.12 11-12-15

Flux "sans COV" pour fluxeur spray, sans nettoyage, sans halogènes

Description:

Le flux PacIFic **2009MLF** a été développé afin de réduire les microbilles. C'est une version adaptée du PacIFic 2009M.

Les flux à braser à base d'eau "sans COV" conventionnels peuvent générer plus de microbilles que les flux à base d'alcool sur les vernis épargnes sensibles aux microbillages.

Le flux PacIFic **2009MLF minimalise les microbilles** sur ces vernis épargnes.

Le flux PacIFic **2009MLF** est absolument sans halogènes. Le flux permet de changer le flux à base d'alcool à un flux à base d'eau sans désavantages.

Le flux PacIFic **2009MLF** est parfaitement adapté au brasage sans plomb et en fluxeur spray.



La photo n'est pas contractuelle

Propriétés physiques et chimiques:

Densité à 20°C	: 1.00 g/ml ± 0.01
Couleur	: liquide incolore
Odeur	: douce
Matière solide	: 3.6% ± 0.2
Présence d'halogènes	: Aucune
Point éclair (T.O.C)	: aucun
Indice d'acide	: 25 mg KOH/g ± 2
IPC/ EN	: OR/ L0

Pourquoi utiliser un flux "sans COV"?

- ▶ Le flux est ininflammable
- ▶ Ne dégage aucun composé organique volatil
- ▶ Supprime toutes les odeurs d'alcool dans les ateliers de production
- ▶ Plus besoin d'utiliser de diluant
- ▶ Élimine les contrôles du pourcentage de matière solide liés à l'évaporation des flux à base d'alcool
- ▶ Améliore la brasabilité et la propreté des cartes
- ▶ Diminue et simplifie les frais de transport, de stockage et d'assurance
- ▶ Réduit la consommation de flux d'environ 30%

Page 1



RoHS
compliant

Informations complémentaires:

Prévention des microbilles	2
Préchauffage	2
Contact vague(s)	2
Sécurité	3
Conditionnement	3

Avantages:

- Minimalise le microbillage
- Absolument sans halogènes
- 100% à base d'eau
- Résiste aux températures élevées
- Presque pas d'odeur
- Des remontées de soudure améliorées



Prévention des microbilles

Plus de flux génère moins de microbilles.

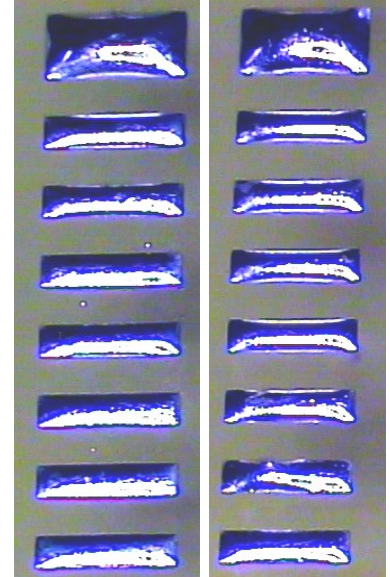
Plus de flux génère également plus de résidus, ainsi la quantité optimale de flux doit être déterminée. Le vernis épargne étant la cause principale de la formation de microbilles, la quantité de flux peut varier selon le vernis épargne qui est utilisé.

Utiliser un carton, en lieu d'un circuit, pour vérifier l'homogénéité du dépôt de flux. Le

carton doit être uniformément mouillé par le flux. Si non, régler les paramètres du fluxeur (vitesse de la buse, quantité de flux, ...) afin d'obtenir un mouillage uniforme du flux.

Pour vérifier un bon mouillage sur le dessus de la carte (remontées de soudure), appliquer du flux sur le dessus de la carte (côté composants traversants)

avec une pinceau fin et comparer les résultats avec les premiers résultats obtenus avec le fluxeur spray de la machine. S'il y a une différence, les paramètres du fluxeur spray devront être réglés. Vous pouvez régler le fluxeur afin qu'il soit plus près de la carte, appliquer plus de flux, appliquer le flux plus lentement ou augmenter la pression du flux. Si ça ne résout pas le problème, contacter INTERFLUX® Electronics.



À gauche: des microbilles sur un flux "VOC free" conventionnel
À droite: Le flux Pacific 2009MLF

Matière solide (sèche)	Min.	Max.
µg/ cm ²	60	140
µg/ in ²	400	900

Quantité d'application typique avec fluxeur spray

"L'eau doit être totalement évaporée avant le contact avec la vague (s)"

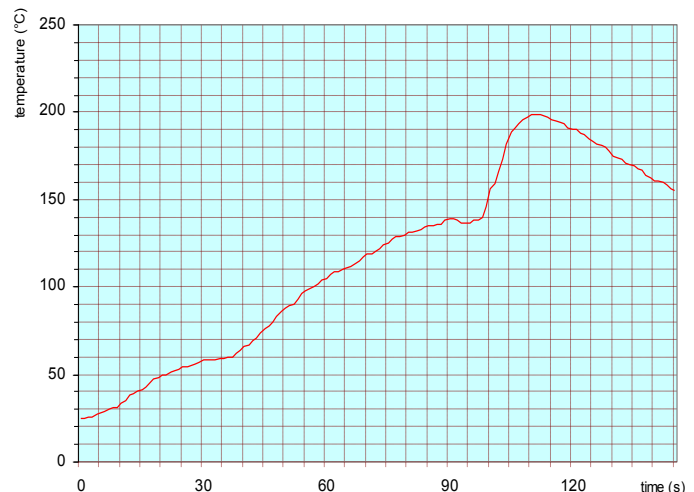
Préchauffage

L'eau doit être totalement évaporée avant le contact avec la vague (s).

Le préchauffage, mesuré sur le dessus du circuit, doit être compris entre 85°C-160°C.

Les paramètres du préchauffage de type convectif ne doivent pas être supérieurs à 150°C. Courbe de préchauffage:

Pente standard: 1,5°C/s
Min: 1,0°C/s
Max: 2,5°C/s



Contact vague(s)

Si vous travaillez en simple vague, le temps de contact standard est de 3-4s. Si vous travaillez en double vague, le temps de contact standard de la première vague est de 1-2s et de 2-4s pour la

deuxième vague. Vous pouvez obtenir un résultat satisfaisant avec un temps de contact plus court, cependant un temps de contact plus important aura l'avantage de bien éliminer le flux lors du contact

vague(s). La limite maximale du temps de contact sera déterminé par l'apparition

des ponts et les propriétés physiques de la carte et des composants.



Résultats des tests de fiabilité

Conformes aux normes EN 61190-1-1(2002) et IPC J-STD-004A

Test	Résultats	Méthodes
Chimique		
Classification du flux	OR LO	J-STD-004A
Miroir de cuivre	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Quantité d'halogènes		
Chromate d'argent (Cl, Br)	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
Quantité d'halogènes	0,00%	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.35
Physique		
Test SIR	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3
Test de corrosion du flux	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.15

Sécurité

S.v.p. consultez la fiche de sécurité du produit

Conditionnement:

Le flux PacIFic 2009MLF est disponible en conditionnement suivant :

Bidon de 10 litres en polyéthylène

Bidon de 25 litres en polyéthylène

Bidon de 200 litres en polyéthylène

Nom commercial du produit : PacIFic 2009MLF VOC-Free No-Clean Soldering Flux

CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

INTERFLUX® ELECTRONICS

Consultez la dernière version de ce document sur:

www.interflux.com/fr

Le document dans une autre langue?:

www.interflux.com